

# PCB 铜箔

HITACHI  
Inspire the Next

日立

## CMI760 系列®

### 了解更多信息

这些仪表是我们的 XRF 镀层分析仪的出色补充。  
如需下订单，请联系

[contact@hitachi-hightech-as.com](mailto:contact@hitachi-hightech-as.com)

### 更多信息

如需了解有关 CMI760® 或 PCB 仪表系列的更多内容，请访问

[www.hitachi-hightech.com/hha](http://www.hitachi-hightech.com/hha)



## 使用一台设备测试铜箔、覆铜板、表面铜、铜线条和孔壁铜厚度

CMI760® 接受多种探针类型，可满足几乎任何 PCB 应用，包括表面铜和孔铜应用。

我们的 CMI760® 标配 SRP-4 探头，并采用先进的统计软件显示测试数据。该仪器具备高度可扩展性，能够实施微电阻和涡电流测试，以准确地高精度测量铜厚。我们提供选购的附件来测量孔铜厚度。

### SRP-4 探头

CMI760® 包括带系绳和用户可更换 SRP-4 探针，带来额外的便利性且更具成本效益。此探针包含 4 个牢固封入的插脚，这一获得专利的设计不仅实现了耐用性，还可抗破裂和磨损。其透明外壳便于在小型轨迹上放置探针。系绳电缆适合于现场应用，并且其占用很小的面积，从而带来便利性和用户友好性。

### 选购的 ETP 探头

借助我们的 ETP 探头，CMI760® 可通过涡电流进行操作。无论板材具有多少层，此探针均可产生准确的读数，并且在如下情况中均有相同的良好测量表现：双面或多层板材、蚀刻前后的板材，以及采用锡和锡/铅电镀的板材。该仪表也提供温度补偿功能，可即时测量从电镀槽中提起的板材。

### 关键特色：

- | 采用双重技术 — 涡电流和微电阻。
- | 采用面铜和孔铜探头。
- | 主动统计显示。
- | 可选购脚踏开关。

通用的双重技术

我们已为 PCB 行业提供了 40 多年的测厚仪产品。

## 仪表规格

- 尺寸 (英寸) :** 11 1/2 英寸 (宽) x 10 1/2 英寸 (厚) x 5 1/2 英寸 (高)。  
厘米: 29.21 (宽) x 26.67 (厚) x 13.97 (高)。
- 重量:** 6 磅 (2.7 千克)。
- 单位:** 从密耳、微米、微英寸、毫米、英寸和 % 中选择一种作为显示单位。
- 显示屏:** 大屏幕 LCD, 像素为 480 (H) x 32 (V), 带背光, 采用广角视图。
- 统计显示:** 读数、标准偏差、均值、高/低。
- 图表:** 直方图、趋势图、x-柱状图和极差图。

## SRP-4 探针:

- 准确度:**  $\pm 1\%$  ( $\pm 0.1$  微米), 参考标准。
- 精度:** 化学铜: 通常为 0.2%。
- 电镀铜:** 通常为 0.3%。
- 分辨率 (密耳):** 大于 1 微米时为 0.01; 小于 1 微米时为 0.001; 大于 10 吋为 0.1, 小于 10 吋为 0.01, 小于 1 吋为 0.001。

## ETP 探头参数:

- 准确度:** 小于 1 密耳 (25 微米) 时为  $\pm 0.01$  密耳 (0.25 微米)。
- 精度:** 在 1.2 密耳时通常为 1.0%。
- 分辨率:** 0.01 密耳 (0.25 微米)。
- 涡电流:** 遵从方法 ASTM E376 厚度范围: 0.08–4.0 密耳 (1–102 微米)。
- 最小孔直径:** 35 密耳 (899 微米)。

## PCB 比较图

我们提供多种用于 PCB 行业的 PCB 仪表, 根据您的应用需求, 为您带来最具成本效益的最佳解决方案。请参考下面的比较图, 或者通过 [contact@hitachi-hightech-as.com](mailto:contact@hitachi-hightech-as.com) 联系我们以获得专家建议。

	CMI95M	CMI165	CMI511	CMI563	CMI760
技术	微电阻	微电阻	电涡流	微电阻	微电阻
铜箔	●	●		●	●
覆铜板	●	●		●	●
铜 - 表面		●		●	●
铜 - 细线		●		●	●
孔壁铜			●		可选
温度补偿		●	●		ETP 探头
更换探针		●		●	SRP-4 探头
单位选择	盎司或微米	密尔或微米	密尔或微米	密尔或微米	密尔或微米
<b>铜厚度范围</b>					
微米	8 个指示灯: 5–140	化学铜: 0.25–12.7 电镀铜: 2–254	2–102	化学铜: 0.25–12.7 电镀铜: 0.25–152	面铜: 0.25–254 孔铜: 1–10
密尔		化学铜: 0.01–0.5 电镀铜: 0.1–10	0.08–4.0	化学铜: 0.01–0.5 电镀铜: 0.01–6	面铜: 0.01–10 孔铜: 0.08–4

我们的全球服务中心网可以为您正常工作提供全面的技术支持:

我们在电镀厚度校准和标准方面已获得 A2LA 认证\*, 这可确保您的 CMI760® 在审核时符合 ISO 17025 规范。

\*A2LA 认证适用于由 Hitachi High-Tech Analytical Science America, Inc. 执行的工作。



如果您想了解关于 CMI760® 仪表的更多信息, 请访问 [www.hitachi-hightech.com/hha](http://www.hitachi-hightech.com/hha), 或者通过 [contact@hitachi-hightech-as.com](mailto:contact@hitachi-hightech-as.com) 发送电子邮件给我们的专家之一以预定演示。

## Hitachi High-Tech Analytical Science

本出版物的版权归 Hitachi High-Tech Analytical Science 所有。本出版物仅提供概要性信息, 除非本公司书面同意, 否则不得为任何目的使用、应用或复制这些信息, 这些信息也不得构成任何订单或合同的一部分或将其视为与相关产品或服务有关的陈述。Hitachi High-Tech Analytical Science 的政策将不断完善。本公司保留更改任何产品或服务的规格、设计或供应条款的权利, 恕不另行通知。

Hitachi High-Tech Analytical Science 承认所有商标和注册。

© Hitachi High-Tech Analytical Science 版权所有, 2017 年。保留所有权利。

